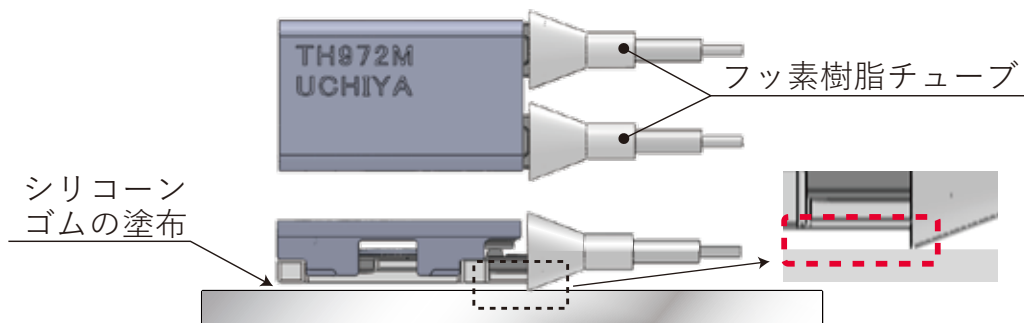


- TH972Mは構成部品にセラミックベースを使用しています。セラミックベースの底面は、平面に置いたときの隙間が0.05mm以内となる平面度です。完全な平面でないため、セラミックベースに過度な荷重が掛かると、セラミックベースが割れる可能性があります。
- TH972Mを取付金具などで固定する場合は、TH972Mを保護対象物（ヒータなど）の平面に設置し、メタルカバーよりも大きな面積を有する取付金具の平面と接触させ、その時の荷重は20N(2kgf)未満としてください。
- 保護対象物とセラミックベースの間にシリコンゴムを塗布すると、熱伝導向上や、接触面の凹凸の緩和、取付時の加圧ストレス軽減を行うことができます。

シリコンゴム推奨品：信越化学工業株式会社 一液型液状ゴム (RTVゴム)
 低分子シロキサン低減品 KE-3493
 (接点障害を引き起こす低分子シロキサンが低減している商品)
 -50°C~+250°Cでの使用可能
 (異常時の短時間の温度上昇であれば+300°Cの耐熱を有する)

- リード線接続部の保護の目的でフッ素樹脂チューブを取り付けると、セラミックベースの底面よりフッ素樹脂チューブが取付面側に突出し段差ができる場合があります。この段差を埋めるためにもシリコンゴムを使用することができます。



- その他の取付方法として、TH972Mをポリイミドフィルム（カプトン®など）で絶縁対策を兼ねて巻き、取付金具で軽く押さえるという方法もあります。
- いずれの場合におきまして、お客様のご使用条件のもとで、適切に保持されていることをご確認ください。振動環境でのご使用は、取り付けの緩みやずれが起こらないようご注意ください。